

NEW

## 立式包装袋顶部焊接密封模块 Telsonic 超声波技术直面包装挑战

塑料焊接

金属焊接

切割

清洗

筛分



布龙施霍芬 (瑞士), 2021 年 9 月

立式袋风靡全球，这是由于制造商与消费者皆可享有这种包装规格提供的诸多优势。随着立式袋应用日益增多，用于密封立式袋的技术需求也相应上涨。Telsonic AG 最新超声波包装技术在此发挥关键作用，不仅是能应对高效技术的需求，还能为客户提供系统规划、规格和集成方面的针对性整体方法。

立式袋具有多重特性，正是它们促使这种包装理念的市场份额不断增长。一方面，摆放在货架上更便于识别与区分产品，另一方面，它们通常要比其他备选包装类型更轻，因此更有助于高效低成本运输。该概念还适用于各种不同的产品类型，包括酱汁、加工食品和宠物食品，而且还是多次填装产品的理想之选，例如皂液或洗涤剂。

不论袋内产品如何，顶部/头部密封保证其完整性，即便时产品颗粒处于密封区域的情况，并且顶部密封的美观度与各侧密封相协调。从生产角度来看，密封技术必须够快、易于使用及快速更换不同封袋类型，当然还有方便维护。

密封此类包装产品的传统方法是热封技术。尽管是一种成熟方法，但热封流程依然存在固有缺陷，其中包括达到最佳运行温度耗费的时间。这不仅增加能源成本，还不利于产能。同样的，如果热封温度过高或者密封时间过长，薄膜可能受损并增加废品率。在日益苛刻的市场环境下，如果制造商想要获得竞争优势，关键在于密封技术能以最高性能、质量和效率运行。

Telsonic 最前沿的超声波创新技术解决了热封工艺的缺陷，在超声波频率 30kHz 及最高 2.4kW 功率的基础上向顶部/头部密封的立式袋提供高性能解决方案。供能的紧凑型数字式 MAG 发生器可轻松集成至控制柜，这项技术采用模块化节省空间的设计，因此可轻松安装至几乎所有填装系统。驱动系统也有多种备选，可采用伺服电机曲柄驱动，或是气动运行。创新型快速更换系统由自校准功能辅助，确保工具更换时间极短，这是保证最高产能水平的关键。



基于伺服电机的驱动配置使用 2×90 度曲柄运动，因此生产率高达每分钟 70 个循环，同时提供最大 1,850N 的密封力。Telsonic 立式包装袋顶部焊接密封模块能够密封宽度达 200mm 的包装袋，如有需要还可生成装饰性焊缝。组合焊头和砧块的制冷装置以及 MAG 发生器的高度动态控制特性，十分有助于实现最高水平的流程稳定性和可靠性。

Telsonic 立式包装袋顶部焊接密封模块可提升机械稳定性，延长使用寿命。作为数字化平台，用户可享受有最新工艺控制、丰富功能以及高水平效率和性能。内置自检流程和错误日志加上可使用快速远程服务，确保停机时间最短。Telsonic 工程师与工艺专家从项目初始概念阶段、组件和模块规格到安装调试皆与客户紧密协作，提供所需服务确保平稳过渡至生产。

采用这种快速高效技术的制造商将很快发现多重优势：

超声波技术优势	客户受益
快速启动	减少废料
焊接时间短	处理量更大
安全焊接—即便产品位于焊缝区域	减少废料且品质更佳
焊头热量最小	不会因热效应损伤薄膜或产品
系统维护少	显著降低修理成本
高能效	降低能耗并减少能源成本
密封缝窄	提升材料利用率并降低成本